浙江晶盛机电股份有限公司 关于终止部分募投项目并将剩余募集资金继续存放募 集资金专户管理以及部分募投项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第二十次会议审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的议案》及《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，董事会同意公司根据实际情况终止向特定对象发行股票募集资金投资项目“年产 80 台套半导体材料抛光及减薄设备生产制造项目”，并将剩余募集资金继续存放公司募集资金专用账户管理，将“12 英寸集成电路大硅片设备测试实验线项目”达到预定可使用状态日期由 2025 年 6 月 30 日延期至 2027 年 6 月 30 日。公司募投项目终止事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体事项公告如下：

一、募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江晶盛机电股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕947 号)，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商兴业证券股份有限公司采用向特定对象发行的方式，向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 21,353,383 股，发行价为每股人民币 66.50 元，共计募集资金 142,000.00 万元，已由主承销商兴业证券股份有限公司于 2022 年 7 月 15 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除承销保荐费、验资费、律师费等与发行权益性证券直接相关的外部费用 397.30 万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 141,602.70 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕360 号）。

募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资

金开户行签署了《募集资金三方监管协议》。

二、募投项目及募集资金使用情况

根据公司《向特定对象发行股票募集说明书》披露的募集资金用途，本次募投项目及截至 2025 年 5 月 31 日募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	承诺投入募集资金	累计投入募集资金	投资进度
1	12 英寸集成电路大硅片设备测试实验线项目	56,370.00	7,717.20	13.69%
2	年产 80 台套半导体材料抛光及减薄设备生产制造项目	43,210.00	2,916.88	6.75%
3	补充流动资金	42,022.70	42,229.81	100.49%
合计		141,602.70	52,863.89	-

三、本次募投项目终止情况说明

1、拟终止募投项目情况

公司“年产80台套半导体材料抛光及减薄设备生产制造项目”总投资人民币50,000.00万元，其中拟投入募集资金43,210.00万元，募集资金投入项目主要用于土建工程和设备购置及安装。项目建成后预计年产35台半导体材料减薄设备、年产45台套半导体材料抛光设备，每年可实现新增销售收入为62,300.00万元，年平均利润总额为16,535.45万元，内部收益率为19.80%（所得税后）。截至2025年5月31日，已使用募集资金2,916.88万元，主要为厂房建设及装修，尚待支付的装修工程款76.98万元，该项目剩余募集资金43,031.09万元（含利息收入及理财收益扣除银行手续费等的净额）。

2、本次终止募投项目的原因

公司“年产 80 台套半导体材料抛光及减薄设备生产制造项目”计划总投资人民币 50,000.00 万元，其中使用募集资金 43,210.00 万元。项目建设规划设备投资 37,401.50 万元，主要为购置龙门加工中心、精密立车、磨床等高端机加工进口设备，以满足年产 80 台套半导体材料抛光及减薄设备的零部件加工制造产能需求。在项目实施建设过程中，随着人工智能、高性能计算、5G、汽车和工业应用等领域的持续发展，半导体行业景气度持续提升，在国产化的行业发展大趋势下，国产设备需求快速增加。公司紧抓行业发展窗口，积极推进项目建设和产能提升，

但相关进口设备的采购周期长，不能满足公司快速响应市场的业务发展需求，为紧抓行业发展机遇，快速抢占市场，公司快速转变发展策略，在供应市场直接采购相关零部件，并通过加强提升自动化和智能化，实施精细化生产管理，提升设备装配制造效率，实现产能的快速提升，顺利把握市场，公司抛光减薄类设备取得快速发展，订单及市场份额快速提升。因而，原计划用于购置进口设备的募集资金大幅节余。

另外，公司全资子公司晶鸿精密依托多年高端精密加工设备投入和高级技术人才储备建设，已发展为拥有精密加工、特种焊接、组装测试、半导体级表面处理等核心制造能力的半导体核心零部件供应商，通过打造核心零部件制造基地，构建了涵盖腔体与结构件（传输腔体、反应腔体、真空腔体等）、功能组件（气体分配盘、精密传动装置、磁流体密封装置、超导磁体等）、耗材与密封件（圆环类组件、腔体遮蔽件、半导体阀门管件等）三大核心产品矩阵，不断提升半导体产业链关键零部件的配套服务能力，已能够逐步满足公司抛光减薄设备核心零部件需求，为进一步提高募集资金的使用效率、避免重复建设，经审慎决定，公司决定不再投建该项目后续的零部件加工设备投入。

3、剩余募集资金安排

截至 2025 年 5 月 31 日，该项目尚未使用的募集资金余额 43,031.09 万元（含利息收入及理财收益扣除银行手续费等的净额），公司终止实施该项目后，该项目剩余尚未使用募集资金（最终以届时募集资金账户实际余额为准）继续存放原募集资金专户，并继续按照募集资金相关法律、法规要求进行存放和管理。后续公司将积极筹划、论证合适的投资项目，对拟投资项目进行科学、审慎的项目可行性分析，确保项目具备较好的市场前景和实施必要性、可行性后，按照相关法律、法规履行审议及信息披露义务后使用该部分募集资金，以保障募集资金使用效率。公司将严格遵守募集资金使用的相关规定，加强募集资金使用的内部管理，确保募集资金使用合法、有效。

四、募集资金投资项目延期的情况说明

（一）募投项目延期的具体情况

公司结合目前募投项目的实际进展情况，在项目实施主体、募集资金项目投资用途及投资规模均不发生变更的情况下，拟对募投项目“12 英寸集成电路大硅

片设备测试实验线项目” 达到预计可使用状态日期进行调整，具体如下：

项目名称	达到预定可使用状态日期（调整前）	达到预定可使用状态日期（调整后）
12 英寸集成电路大硅片设备测试实验线项目	2025 年 6 月 30 日	2027 年 6 月 30 日

（二）募投项目延期的主要原因

公司“12 英寸集成电路大硅片设备测试实验线项目”拟通过添置先进高效的实验和清洗、检测等设备，构建包含长晶、截断、切片、研磨、抛光、清洗、检测等多工序的设备实验线。近年来，我国半导体行业持续发展，产品质量不断提升，公司紧跟行业发展趋势，在项目建设过程中，积极推动技术和工艺创新，深化测试设备技术和工艺的迭代升级，并协同上下游进行迭代后设备的技术验证，相关投入设备的测试及验证周期较长，综合考虑设备迭代及安装、调试等建设节奏，该募投项目总体达到可使用状态日期将有所延后。公司将持续加强募投项目建设管理，积极推进募投项目建设。

（三）对延期募投项目的重新论证

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，公司对募投项目进行了重新论证。

1、项目建设的必要性

（1）进一步改善公司测试条件，满足建设更高标准实验室的需求

经过多年发展，公司成功研发出应用于半导体硅棒晶体生长、外圆滚磨、截断、切片、研磨、减薄和抛光等工序的设备，在半导体硅片制备领域市占率领先。半导体硅片对制造设备的要求不断提升。现阶段，公司的大硅片产线设备测试，特别是每个环节材料的参数和工艺性能的验证，较大程度依赖于下游客户，这种情况既不利于缩短 12 英寸大硅片生产和加工设备的验证周期，又难以及时满足市场对大硅片制造设备的迫切需求。同时，现有硅片制备产品迭代更新以及新产品研发和产业化更是需要配套试验检测设备及试验场地来支撑。

为进一步提高公司晶体生长、滚磨、截断、切片、研磨、减薄、抛光等设备的研发和测试效率，提升公司核心竞争力，公司迫切需要配置行业前沿的试验检测设备，建设满足高标准要求的试验环境场地，完善公司在试验检测环节的硬件设施，以匹配公司随着研发要求提升带来的检测试验需求。基于此，本项目将以完备的检测设备和先进、高标准、高质量的测试场地为基础，覆盖多场景、多工

序、不同指标的试验检测能力，积极追踪和运用半导体新技术，促进新技术与企业业务融合，实现产品较快的优化以及迭代升级。

（2）提升产品研发和测试能力，推动企业硅片设备的工艺改进

本项目公司拟建设洁净房，同时配置国内外先进的实验及检测仪器设备，项目完成后，测试实验中心将覆盖国内及国际标准需求的 12 英寸集成电路大硅片全自动晶体生长炉、单晶硅截断机、单晶滚磨机、金刚线切片机、研磨机、减薄机和抛光机等设备的综合性能试验，涉及长晶、滚磨、截断、切片、研磨、减薄、双面抛光、边缘抛光、最终抛光等硅片生产和加工工序。一方面，本项目将针对设备的技术参数、功能、性能、环境适应性、设备材料等关键项目进行测试，满足半导体硅片制造设备及其关键部件的实验、测试、检测及验收工作，不仅将丰富公司设备研发和测试的经验，而且有助于企业对设备进行改造、优化和升级。另一方面，通过本项目的顺利实施，企业在半导体材料设备测试和实验过程中，通过收集实验数据，能不断地补充、完善企业的工艺数据库，改进设备工艺，加速公司半导体设备的产业化进程。

（3）进一步培育研发及工艺人才，加速企业科技成果的转化

半导体硅片行业具有人才密集型的特点，需要投入大量的资源用于人才培育。国内半导体硅片企业多处于成长期，只有加大人才培育，才能保证持续的技术创新和产品创新，这对于增强企业核心竞争能力、保持行业领先地位十分重要。公司始终以技术创新作为持续发展的动力源泉，为实现“先进材料，先进装备”的发展战略，公司亟需改善现有的研发和测试环境，以吸引和培育高素质研发及工艺人才，加速企业科技成果的转化。

本次设备测试实验线建设项目将配置高端检测设备，搭建测试实验室和完善测试体系，项目完成后，公司不仅可以依托高规格的测试中心吸引更多高素质研发和工艺人才，而且有助于开展不同维度、不同工序、不同应用场景的产品测试，锻炼和培育熟悉晶体生长和硅片加工等多种工艺的技术人才，进而改进长晶、滚磨、截断、切片、研磨、减薄、双面抛光、边缘抛光、最终抛光等关键设备的核心技术工艺，将有市场潜力的技术开发成果通过研究及测试，形成可批量生产的产品，加快公司科技成果的转化。

（4）持续强化企业先发优势，助力半导体硅片产业链的国产替代

半导体硅片生产和加工设备具有资金投入大、技术门槛高、客户认证周期长的特点。近年来，为推动我国集成电路产业的发展、增强信息产业创新能力和国际竞争力，国家从宏观到微观层面先后出台了大量鼓励扶持政策与规划，促进国内企业在半导体设备、材料、设计等各个细分领域的重点突破，以实现我国半导体产业的自主可控，突破国外相关设备和技术的封锁，而半导体硅片生产、加工设备和相关辅料耗材作为半导体产业链的关键环节，提高其国产化率、实现进口替代是我国半导体行业亟需突破的产业瓶颈。本次项目将提升公司在 12 英寸集成电路大硅片设备和相关辅料耗材的实验和测试能力，不仅有助于相关设备的研发、改造和升级，弥补我国大硅片制造设备的短板，而且能加速对辅料耗材的研究进程，对半导体硅片设备和辅料耗材的国产化具有十分重要战略意义。

2、项目建设的可行性

（1）经验丰富的研发团队及技术储备为项目实施提供了人才和技术保障

在多年的研究工作积累中，公司培养了一支以教授、博士、硕士为核心的专业化程度高、应用经验丰富、执行力强的研发团队。专业背景涵盖机械、机设、机电、自动化、电气、计算机、软件工程、信息工程、材料等多个专业，核心技术人员在半导体领域拥有多年的技术研发经验，综合技术素质较高。在公司核心技术人员曹建伟、朱亮、傅林坚等博士的带领下，公司承担了多项国家科技重大专项课题和浙江省工业类重大科技专项项目，搭建了从开发流程到产品设计、产品标准、试验验证，再到产业化的完整创新链条，具备了半导体硅片相关设备的持续创新能力。

公司经过多年的科研攻关和技术创新，在半导体材料用关键设备领域实现国产化突破，部分关键技术处于行业领先水平，已掌握了单晶硅生长全自动控制技术、热场仿真技术、金刚线切片、研磨、双面抛光、单面抛光、边缘抛光等多项先进技术，同时成功开发了 12 英寸用晶体滚磨机、单晶截断机、双面研磨机、边缘抛光机、双面抛光机、最终抛光机等设备。形成了“在研项目—成熟项目—产业化项目”逐层推进的良性循环，积累了一些具有市场发展前景的储备产品。

（2）公司丰富的设备研发测试经验为项目实施提供了经验基础

公司拥有国家企业技术中心、国家级博士后科研工作站、浙江省半导体智能制造重点企业研究院、浙江省半导体材料生长加工装备重点企业研究院等研究平

台，为确保产品符合国际和国内的认证标准，公司建立了完善的研发体系，研发中心按照职能分为晶体装备生长研究所、工业自动化研究所、抛光设备研发所、材料加工装备研究所、精密部件研究所、晶体实验室等多个二级部门，分别负责相关产品和工艺的开发工作，同时各研发部门成立项目管理团队，对研发项目进行里程碑式节点管理，在长晶、切片、研磨、抛光等关键设备的研发和改造过程中，积累了丰富的设备研发、检验、测试、校准经验。公司在设备研发测试方面的丰富经验有助于本次项目的顺利实施。

(3) 国家政策鼓励企业进行技术创新为项目实施提供了政策支持

在经济全球化的进程中，以高科技为先导的企业技术创新是推动各国经济发展的重要力量。为了扶持科技型企业的发展，中共中央、国务院、国家工信部等相关部门颁布了《中国制造 2025》、《国家创新驱动发展战略纲要》等一系列法律法规和政策支持企业自主技术发展，全面提升自主创新能力。2021 年 3 月，国务院提出大力促进科技创新，加强关键核心技术攻关，支持科技成果转化应用，促进大中小企业融通创新，推广全面创新改革试验相关举措。2021 年 3 月 11 日，十三届全国人大四次会议表决通过的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》提出要鼓励民营企业改革创新，支持民营企业开展基础研究和科技创新，参与关键核心技术研发和国家重大科技项目攻关。此外，浙江省也发布了《关于加快建设高水平新型研发机构的若干意见》等政策，推动省级重点企业研究院瞄准世界科技前沿和新材料等创新高地，攻克一批关键核心技术，向高水平新型研发机构提升。

五、本次募投项目终止及延期事项对公司的影响

本次终止部分募投项目系公司根据行业发展以及公司业务发展和产能规划的实际情况做出的审慎决策，不会对公司正常经营产生重大不利影响。本次终止部分募投项目有利于提高公司募集资金使用效率，优化资源配置，符合公司未来发展的战略要求，不存在损害股东利益的情形。公司将严格遵守《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，加强募集资金使用的管理，确保募集资金使用的合法、有效。

本次募投项目延期符合项目建设的实际情况，不涉及募项目实施主体、募集

资金项目投资用途及投资规模的变更，不会对募投项目的实施产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。本次调整是为了更好地保证募投项目建设质量，实现募投项目建设目标，符合公司长期发展规划。公司将继续加强对募投项目建设进度的管理和监督，保障项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率。

六、公司履行的审议程序及相关意见

（一）董事会审议情况

2025年6月27日，公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的议案》及《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司终止向特定对象发行股票募集资金投资项目“年产80台套半导体材料抛光及减薄设备生产制造项目”，将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理，并提交公司股东大会审议；同意将“12英寸集成电路大硅片设备测试实验线项目”达到预定可使用状态日期由2025年6月30日延期至2027年6月30日。

（二）监事会意见

2025年6月27日，公司第五届监事会第二十次会议审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的议案》及《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，监事会认为：本次终止部分募投项目，是结合行业发展并综合考虑公司业务实际情况而做出的审慎决定，有利于提高募集资金使用效率，符合公司未来发展战略及全体股东利益。本次部分募投项目延期事项，符合募投项目建设的实际情况，募投项目的实施主体、投资用途及投资规模均未发生变化，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次募投项目终止及延期事项不会对公司正常生产经营造成重大影响，审议程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的要求。监事会同意本次募投项目终止及延期事项。

（三）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：本次终止部分募投项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理以及部分募投项目延期是公司根据实际经营发展需要作出的决

策，不存在损害股东利益的情形。本次终止部分募投项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理事项已经公司董事会和监事会审议通过，本事项尚需经股东大会审议通过；部分募投项目延期已经公司董事会和监事会审议通过，履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规、规范性文件的要求。综上，保荐机构对公司本次终止部分募投项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理以及部分募投项目延期事项无异议。

七、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第二十次会议决议；
- 3、兴业证券股份有限公司出具的核查意见。

特此公告。

浙江晶盛机电股份有限公司

董事会

2025年6月28日